

5G芯片大战开启 国际大厂抢行 国内厂商紧跟之下胜负难料

在日前举行的高通 4G/5G 峰会上，高通正式宣布推出基于面向移动终端的 5G 调制解调器芯片组，并成功实现了 5G 数据连接。如果没有意外，手机厂商们明年就能完成 5G 手机的设计，让 5G 手机商用走入现实。鉴于此，一场 5G 芯片大战已经悄然开启。

本刊记者 | 孙永杰

作为备受期待的下一代通信系统，5G 将实现远超 4G 的性能。按照最新的时间表，在全球范围内，5G 的大规模商用最早将于 2019 年开始，而中国的 5G 商用则有望在 2020 年成为现实。要实现 5G 商用，需要两个基础条件：一是运营商建立 5G 商用网络，二是设备商制造出支持 5G 的终端。两者缺一不可。而对于终端，芯片又是重中之重。

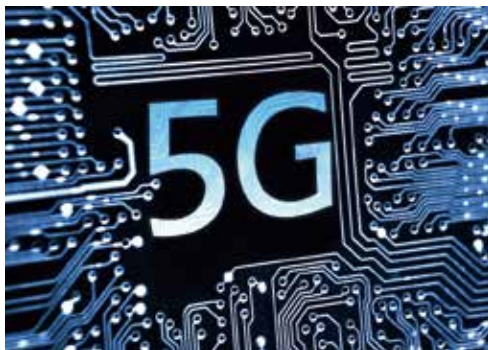
昔日宿敌 高通与英特尔争抢 5G

英特尔，x86 CPU 界的霸主；高通，移动 CPU 巨头。两家公司近几年一直都是华尔街有意撮合的对象。但 5G 时代序幕刚揭开，命运似乎又一次将他们拉到对立面。

在日前举行的高通 4G/5G 峰会上，高通正式宣布推出基于面向移动终端的 5G 调制解调器芯片组 X50，并成功实现了 5G 数据连接。

对此，高通执行副总裁兼 QCT 总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示：“基于骁龙 X50 5G 调制解调器芯片组在 28GHz 毫米波频段上实现全球首个正式发布的 5G 数据连接，真正彰显了高通在 5G 领域的领导地位和移动连接技术方面的深厚积淀。这项重要里程碑和我们的 5G 智能手机参考设计充分展现了高通正在推动移动终端领域内 5G 新空口的发展，以提升全球消费者的移动宽带体验。”

针对高通的举措，英特尔也不甘示弱，随即正式宣布了 XMM 8000 系列 5G



基带芯片。据外媒报道，英特尔 XMM 8000 系列基带芯片首个型号敲定为 XMM 8060，支持最新的 5G NR 新空口协议，向下兼容 2G/3G/4G，包括 CDMA。按照英特尔的说法，搭载 XMM 8060 基带的 5G 设备将在 2019 年中旬出货。

尽管如此，若想要撼动高通在基带芯片领域的主导地位，目前英特尔的产品蓝图看来还不足以令人信服，但英特尔至少找来了一个背书的好伙伴，便是苹果，趁着苹果与高通分道扬镳的契机，英特尔的 5G 之路，至少在基带芯片领域获得了苹果强有力的支持。而英特尔截至目前为止的开发成果，不仅已经让苹果连续 2 年采用其基带芯片，更有苹果工程师放出消息，iPhone 进入 5G 手机时代后，将采用英特尔的 5G 基带芯片。值得注意的是，英特尔在宣布 XMM 8060 基带芯片时，并未局限于手机应用，XMM 8060 未来还将应用在各种移动设备，这一点为业内留下了许多想象的空间。

华为、展讯等厂商奋起直追 胜负难料

面对上述全球芯片大佬在 5G 芯片的发力，以华为、展讯为代表的国内厂商也在积极备战。

华为公司无线解决方案部门的 CMO Peter Zhou 接受外媒 Computerbase 采访是表示，海思正在跟进 5G 网络（相关基带研发），而支持这个网络的麒麟处理器也在开发当中，目前一切进展良好，相关成品会在 2019 年推出。

相比之下，展讯目前研发 5G 全面提速，已组成上百人团队加速 5G 芯片研发，在终端侧，也与华为、爱立信、中兴通讯展开落地测试，最快 2018 年下半年推出芯片，要在 5G 时代追上竞争对手高通。为了在标准化 3GPP R15 的第一个 5G 版本冻结前及早卡位，迅速流片，展讯全力冲刺 2018 年下半年拿出一个 5G 的商用芯片。

除了华为、展讯外，在高端移动芯片败给高通的联发科，将翻身的希望寄托在 5G 身上。为此，联发科也正在加速发力基带，并有望在今年年底完成 5G 原型芯片的设计，明年投入验证阶段。

而刚刚在营收上超越英特尔成为芯片产业老大的三星自然也不会轻易放过 5G 的机会。三星表示，今年早些时候发布的 Exynos 9 处理器整合了 LTE Cat.16 级别的基带芯片，这是行业内首款支持 5CA 的芯片，能够实现峰值 1Gbit/s 的下载速率。

虽然主流芯片厂商都对于 5G 芯片虎视眈眈，但市调机构 Strategy Analytics 近日发布报告预测，5G 智能手机将在 2019 年商业化，不过直到 2022 年，4G 手机仍会是市场主流。这意味着，新的 5G 芯片大战谁能最后胜出仍难以预料。